



# 先端ファブ리케이션研究会 2022年度 第9回公開研究会

主催：先端ファブ리케이션研究会

## ◆公開研究会のご案内

### 「2.xDパッケージを実現する微細配線の装置と材料」

エレクトロニクス実装学会・配線板製造技術委員会(委員長・北本 仁孝:東京工業大学)／先端ファブ리케이션研究会(主査・松本 克才:八戸工業高等専門学校)では、下記要領で公開研究会を開催致します。2.xD高次元実装技術関連に対し、半導体分野全体から見た実装技術の概要を基調講演で確認しつつ、基板製造材料や装置側から見た実装技術の最新トレンドを研究していきます。「2.xDパッケージを実現する微細配線の装置と材料」をテーマとして、ご講演いただきますので、皆さん奮ってご参加下さい。

開催日時 2022年12月2日 13:20～17:05

開催方式 WEB研究会(Zoom Webinarシステム利用)

※参加URL等の聴講情報は、申込受付時のメールにてご連絡致します。

13:20～13:25

オープニング

司会 佐藤 牧子氏 先端ファブ리케이션研究会

13:25～14:15

「テーマ チップレット集積技術の動向」

東京工業大学 栗田 洋一郎 教授

<概要>チップレット集積に関するハードウェアのプラットフォーム技術について概要と最新動向を紹介する。

14:15～14:55

「テーマ FOLP@ならびにチップレット集積化Die-to-Die Pillar-Suspended Bridge(PSB)技術について」

アオイ電子株式会社 河野 一郎 氏

<概要>①FOLP@のプロセス、パッケージの特徴およびアプリケーションの提案  
②東京工業大学を主体としたチップレット集積プラットフォーム・コンソーシアムで共同開発したPSB技術によるチップレット集積構造のコンセプト実証結果について報告する。

14:55～15:35

「テーマ 3Dパッケージを実現する微細配線用露光装置」

株式会社アドテックエンジニアリング 海野 和也 氏

<概要>露光装置、特に直接描画装置を中心に現状と将来について解説する。

休憩10分

15:45～16:25

「テーマ 次世代情報通信向け絶縁材の技術動向」

味の素ファインテクノ株式会社 野崎 浩平 氏

<概要>次世代の高速伝送や多層化、微細化するパッケージに対応した Ajinomoto Build-up film(ABF)ならびに関連材料に関して解説する。

16:25～17:05

「テーマ 次世代半導体パッケージ基板に適する無電解銅めっきプロセス『OPC FLETプロセス』」  
奥野製薬工業株式会社 本間 秀和 氏

<概要> 電子機器等の電子機器等の小型化・高密度化に伴い配線の微細化が進み、ビア底部の面積も縮小するため内層銅と高い接続信頼性が得られる無電解銅めっきプロセスの要求が高まっている。従来プロセスでは無電解銅めっき皮膜を境に結晶方位が変化することで剥離が発生し、接続信頼性低下の原因となる。このためビア底部において結晶方位が揃った状態である結晶連続性が求められる。本講演では無電解銅めっき皮膜の厚みや純度、内層銅上の有機物残渣など、結晶連続性に悪影響する阻害因子を調査した。その対策を講じた無電解銅めっきプロセス「OPC FLETプロセス」にて結晶連続性が得られ、内層銅と高い接続信頼性が得られたことを報告する。

※プログラムは変更になることがありますので、ご了承ください。

## 参加要項

定員 150名(先着申込順 定員になり次第締め切ります)

参加費(消費税込み)

正会員:5,000円、学生会員:1,000円、研究会会員:別払い、シニア会員:1,000円

名誉会員: 無料、賛助会員の社員:5,000円、賛助会員(クーポン利用):無料

非会員一般:10,000円 非会員学生:1,000円

## 注意事項(参加方法)

- ①申込が受理されますと、**返信メールで公開研究会への参加 URLやお支払いに関する情報**をご連絡致します。
- ②ご申請の手順に従って、参加費のお支払いをお願い致します。  
(お支払い方法:銀行振込・クレジットカード決済)
- ③請求書や振込確認後の領収書のご発行は、返信メールのマイページから出力が可能です。
- ④WEBの請求書が原紙扱いになりますので、ご了承ください。
- ⑤賛助・特別クーポンは、1枚/1口まで(複数口の場合は口数分)利用可能です。申込時にクーポン番号等の全項目を記入しないと、利用できません。  
※複数枚使用希望がある場合はお問い合わせください。

\*キャンセルポリシー

お申込み後のキャンセルはできません。

**下記から参加申し込みをお願いします。**

**会員/賛助/非会員の方**

※クーポン使用の場合は「クーポン利用」をご選択ください。

問い合わせ先 一般社団法人エレクトロニクス実装学会

E-mail: info@jiep.or.jp

(メールアドレスは¥を@に置き換えてください)